

## S3088 *ultra chrome* | sistema SPI



**Cadencia extremadamente alta  
por el manejo FastFlow**

**Calidad optimizada de inspección  
y velocidad de inspección**

**4 vistas angulares para las  
imágenes libres de sombreado**

**Alta reproducibilidad**

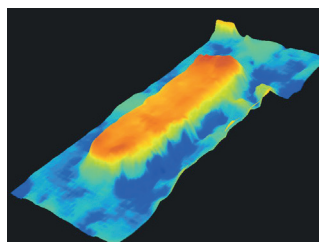
**Manejo muy sencillo:  
imágenes de colores para la verificación  
y creación eficiente de programas**

**Viscom Quality Uplink para obtener los  
mejores resultados del First Pass Yield**

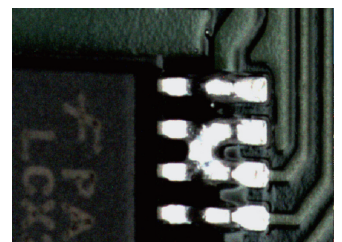
### Inspección 3D de soldadura de pasta a gran velocidad con máximo control de calidad

El sistema S3088 *ultra chrome* 3D SPI ofrece ventajas insuperables para una fabricación de SMT más rentable. Entre las características más importantes se encuentran la velocidad de inspección de 90 cm<sup>2</sup>/s y un tamaño de campo de visión de 60 mm por 60 mm. La resolución óptica ortogonal es de 10 μm que en combinación con cuatro vistas angulares ofrece resultados de inspección perfectos y libres de sombreado, lo que es un punto clave en campos de inspección de áreas muy reducidas. Cadencia extremadamente alta por el manejo opcional FastFlow de Viscom. La alimentación y extracción de los componentes se realiza de forma sincronizada y con alta velocidad. Este sistema es configurado especialmente para satisfacer los aspectos óptimos de costo/beneficio, y se basa en la exclusiva tecnología de las cámaras XM de Viscom que combina una detección de defectos precisa con la máxima velocidad de inspección. El sistema S3088 *ultra chrome* comprueba todos los criterios de calidad para los pads impresos, como el volumen, la forma, superficie, altura, desalineación, puentes de pasta y mala colocación o impresión.

Gracias a la evaluación de la información de medición 3D y al envío de datos a través de la interconexión Quality Uplink que comparte los resultados con la impresora de pasta, sistemas de colocación automáticos, AOI y AXI se pueden llevar a cabo controles de procesos más efectivos y la optimización constante de la calidad. El sistema SPI en 3D de Viscom proporciona indicaciones acerca de las debilidades del proceso que deben ajustarse automáticamente, como por ejemplo la adaptación de los ciclos de limpieza de los filtros o la corrección de la desalineación de impresión, o bien la compensación del equipamiento.



Determinación 3D del volumen de pasta de soldadura con colores



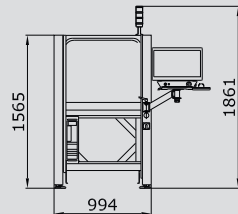
Puente de pasta según la soldadura

3D SPI

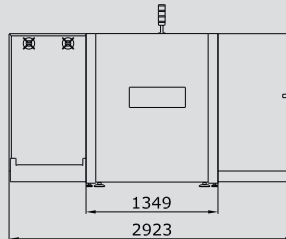
# Datos técnicos



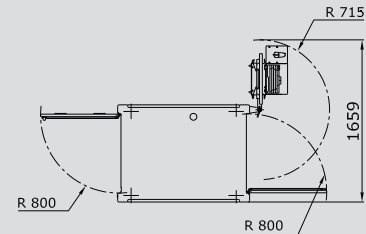
Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Expresado en mm

## S3088 ultra chrome | modelo de sistema SPI

<b>Alcance de la inspección</b>	SPI en 3D	Control de los depósitos de pastas de soldadura (impresión de moldes y tecnologías de dispensadores con tamaños de pad máximos para componentes 01005) y también es posible la inspección de la pasta de sinterizado. Inspección de la presencia, superficie, altura, desalineación de impresión (desalineación X/Y), lubricado y opcionalmente: forma, coplanaridad, análisis de superficies libres, OCR, DCM
<b>Tecnología de sensores</b>	<b>Tecnología de sensores 3D</b>	
	Procedimiento de medición	Escáner de luz estructurada
	Resolución en Z	0,1 µm
	<b>Cámaras de vista angular</b>	
	Número de cámaras de megapíxeles	4
<b>Cámara ortogonal</b>	<b>Resolución</b>	20 µm estándar, 10 µm de alta resolución
	Tamaño de campo de visión	60 mm x 60 mm
<b>Datos de desempeño</b>	Precisión de repetición en medición de altura	2 µm (sobre el blanco de certificación), altura <<10% @ 6 σ (sobre el blanco de certificación)
	Altura de la pasta máx.	4000 µm
<b>Software</b>	Interfaz de usuario	vVision/EasyPro de Viscom
	Control estadístico de procesos	SPC de Viscom, interfaz abierta (opcional)
	Estación de verificación	vVerify/HARAN de Viscom
	Diagnóstico remoto	SRC de Viscom (Software Remote Control) (opcional)
	Estación de programación	PST34 de Viscom (opcional)
<b>Ordenador en España, computadora o PC en Latinoamérica del sistema</b>	Sistema operativo	Windows®
	Procesador	Intel® Core™ i7
<b>Manipulación de PCBs</b>	Concepto de transporte	Modelo de sistema S3088 DT con pista de transporte individual y doble
	Tamaño de PCBs (longitud x anchura)	508 mm x 508 mm, opción disponible de longboard
	Altura de transferencia	850 - 950 mm ± 20 mm
	Ajuste de ancho	Automático
	Fijación de PCBs	Neumática
	Altura de paso superior (máx.)	50 mm
Altura de paso inferior	45 mm, hasta 85 mm opcional (con soporte de placas 40 mm)	
<b>Velocidad de inspección</b>		Hasta 90 cm <sup>2</sup> /s
<b>Otros datos del sistema</b>	Unidad de posicionamiento	Motores lineales síncronos
	Interfaces	SMEMA (estándar), estándar IPC Hermes, otras interfaces bajo demanda
	Conexión eléctrica	400 V (otras tensiones bajo demanda), 3P/N/PE, 8 A, presión de trabajo 4-6 bar
	Dimensiones del sistema	994 mm x 1565 mm x 1349 mm (anchura x altura x profundidad)
	Peso	720 kg

Encuentre nuestras filiales internacionales y representantes en:

[www.viscom.com](http://www.viscom.com)